

帝京半导体科技（沈阳）有限公司

----- 半导体设备零部件解决方案领先服务制造商

内容

Contents

1

-- 公司概况 --

2

-- 产品实现过程 --

3

-- 技术能力与产品 --

4

-- 帝京客户 --

Part 1

公司概况

公司概况



公司总部苏州公司



沈阳分公司



天津分公司



南通分公司

公司概况

帝京半导体科技（沈阳）有限公司，成立于**2024**年，注册资本**2000**万元，公司位于辽宁省沈阳市浑南区创新三路**29-13**号，南接桃仙机场，北连沈阳浑南高速路口，地理位置优越，交通便利，便于物流运输。母公司帝京半导体科技（苏州）有限公司位于苏州市高新区，下辖帝京半导体科技（南通）有限公司，帝京真空技术（天津）有限公司，帝京半导体科技（沈阳）有限公司三家全资子公司。帝京半导体作为专业的半导体设备零部件技术开发及制造高新技术企业，以半导体真空部件及表面处理技术为核心，集合材料工程、超精密加工、精密检测、超洁净清洗、精密检测、无尘包装等工艺打造一站式快速响应客户需求的服务平台。

公司拥有高素质技术团队，具备强大的设计、研发和生产能力，购进先进机械设备，能够满足各种复杂工艺需求，产品广泛应用于半导体、新能源汽车、军工、航空航天、精密仪器等多个领域，能够为客户提供从产品设计、加工工艺、质量控制到售后服务的全方位解决方案。公司与沈阳新松机器人自动化股份有限公司、沈阳芯源微电子设备股份有限公司等多家大型半导体企业建立长期稳定的合作关系。

公司将持续秉承“质量第一，客户至上”的经营理念，不断提升技术实力和服务水平，关注行业前沿动态，加强与科研机构、高校等合作，推动产学研深度融合，为公司持续健康发展提供有力支撑，加大市场开拓力度，积极拓展国内外市场，实现公司跨越式发展。

愿景、使命与核心价值观

愿景： 成为卓越的世界级制造企业

使命： 为客户提供零部件解决方案
为员工创造物质和精神幸福
为国家先进制造发展做贡献

核心价值观： 全心全意为客户服务

业务模式

Business Model

Professional semiconductor equipment parts
one-stop station solution provider
专业的半导体设备零部件一站式解决方案提供商

半导体设备及
零件到组件的
一站式垂直整
合的制造能力

具有关键制造
技术并已通过
半导体行业大
厂专业认证

以精密洗净和表面处理技术为核心
整合材料工程、精密加工+、精密测量等专业
技术，为设备厂、晶圆厂提供整体解决方案

材料工程、
精密加工+

精密测量、
实验室检测

材料、机械、
表面处理、洁
净包装等工艺
领域工程能力

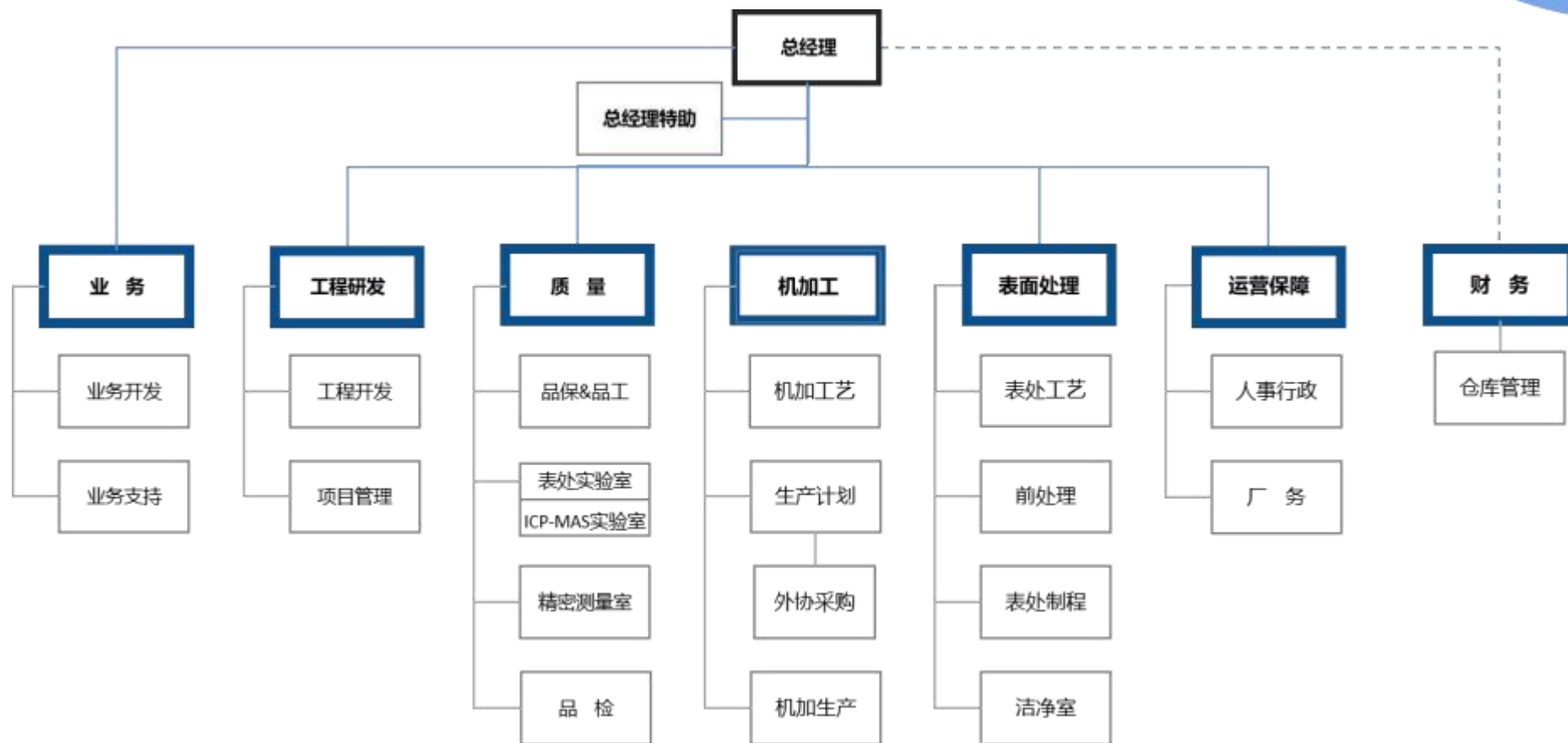
完善的工程设
计、制造、质
量和供应链管
理体系

化学清洗
表面处理
(核心竞争力)

组织架构

CORETEAM

公司核心团队6人,全都曾就职于国际半导体企业工程、表面处理,机械加工等关键岗位,具有10多年深厚技术和管理经验。

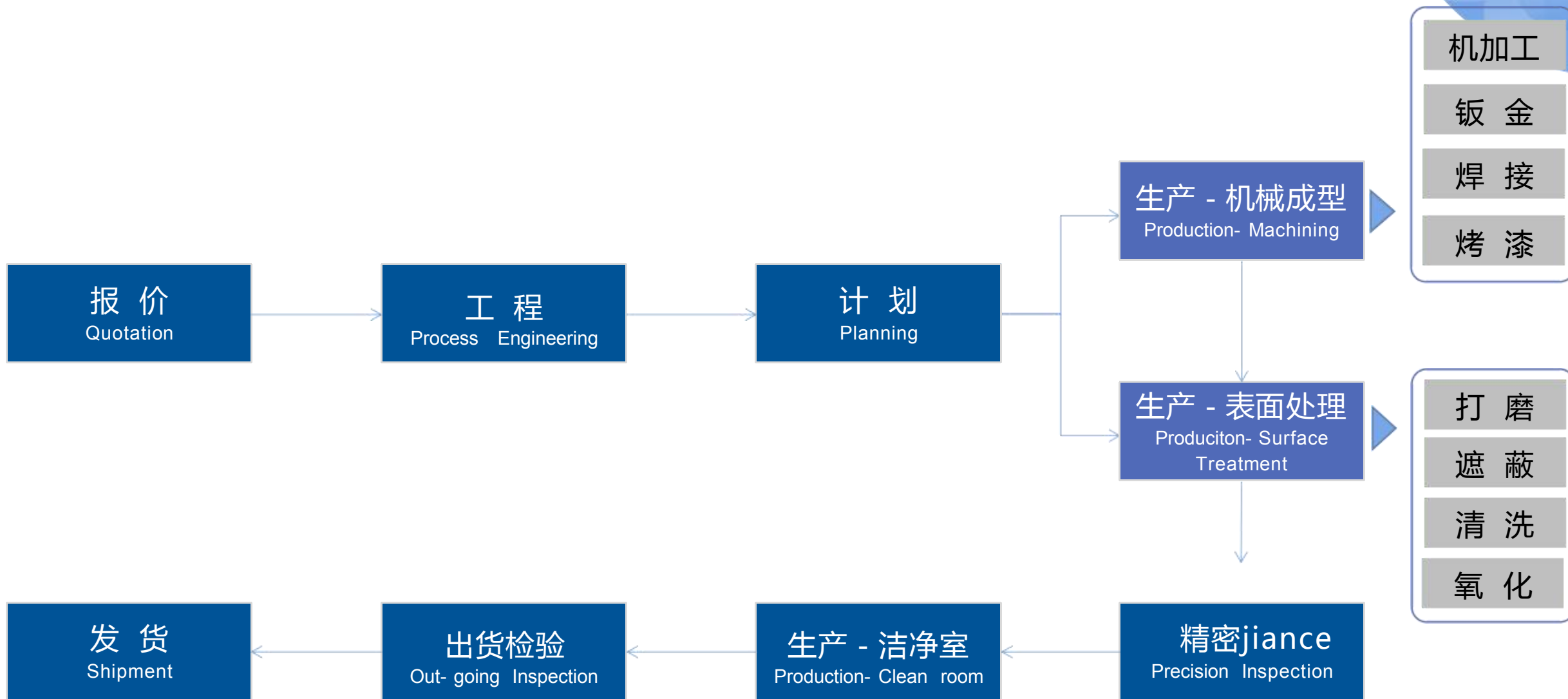


学历	百分比
博士&研究生	10%
本科	30%
大专	40%
中专	20%

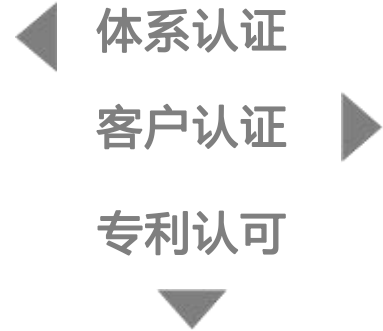
Part 2

产品实现流程

产品及服务实现过程



质量保证与工艺创新



Part 3

技术与产品

帝京技术和生产能力

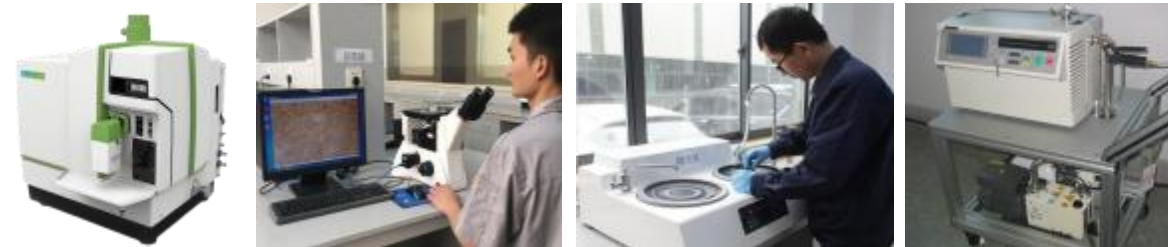
组装及洁净室包装 Assy. & Cleanroom Packing



建立了千级和百级洁净室，能够为UHV特高压元件提供超洁净清洗和包装服务，此外还配置了组装工程技术研发团队

DJ-Tech

工程技术能力 Engineering Capability

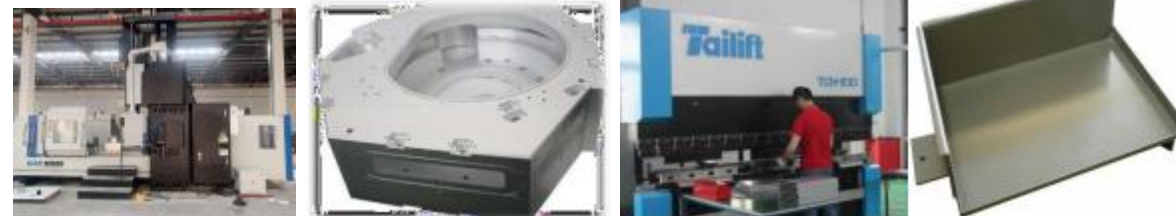


建立了材料、精密检测及表面处理实验室，配备质谱仪、光谱仪、化学成分检测、氦测仪、膜厚仪、CMM、OGP等各类精密仪器



配置了自动化控制清洗和氧化线，能够提供化学清洗、阳极氧化、烤漆、喷砂、熔射、特殊涂层等半导体零件表面处理工艺服务

表面处理 Surface Treatment



配置完备的精密机械加工设备，实现从制程腔体到精细零件的机加工、钣金、精密焊接乃至喷涂等工艺流程加工服务

精密加工（机加工、焊接、钣金） Precision Manufacturing+

关键产品和主要设备 - 机加工

产品定位：

1. 腔体**Chamber** (铝合金+不锈钢)
2. 零部件 **PARTS** (各种内衬， 门板， 匀气盘)



Capabilities-Machining

Hard metal /Large size machining
(4 m/c / 20000hrs cap.)

GUOSHEN iVT600

Verticle Lathe

GUOSHEN 3018

Gantry CNC

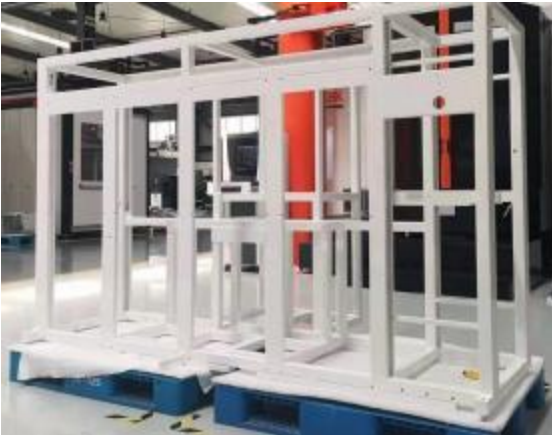


关键产品和主要设备 - 钣金

产品定位：

1. 骨架 FRAME (Carbon steel baking paint + stainless steel skeleton)
2. 钣金件 SHEET METAL (Supports, door panels, boxes)

Frame



BOX



Capabilities-SHEET METAL

Welding machine



Bending machine



Laser cutting



关键产品和主要设备 - 表处

Capabilities-SURFACE TREAT

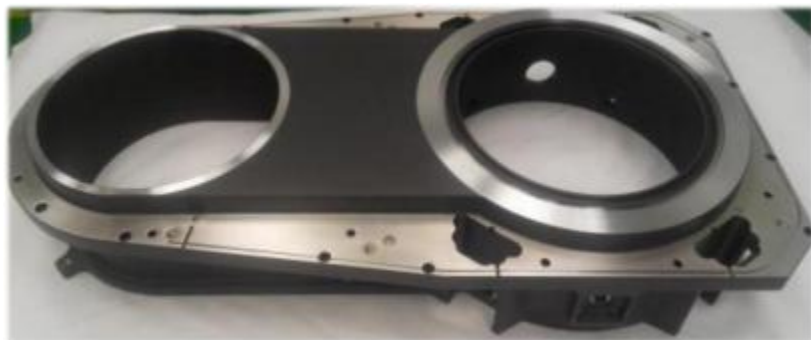
产品定位：

1. 化学清洗 (UHV cleaning)
2. 表面涂层 (Anodize , ARC spraying , Y2O3)
3. 烤漆 (PAINTING)

UHV
cleaning



Chamber Anodize



Chemical analysis



Class 100 CLEANING ROOM



Frame painting



Automatic prod. line



表面处理技术能力

材料 Material	制程 Process	标准 Standard	加工有效尺寸 Processing Size	通过客户认证 Customer certification
铝合金 Aluminium alloy	化学清洗 Chemical Cleaning	ASTM/GB	2000×800× 1500mm	AMEC, ULVAC, 汉能
	喷砂 Bead-Blasting	ASTM/GB	900×800×580mm	Ra:1-10 μm (精度±10%)
	硫酸阳极、硬质阳极、草酸阳极 Anodic Oxidation	MIL-A-8625	2000×800× 1000mm	LAM / NAURA / HITACHI 硬阳 盐酸测试 > 4小时 , 硬度 > 400HV
	电解抛光 ElectroPolishing	ASTM-B-912	1000× 1000×800mm	亮面雾面
	刷镀镍 BrushingNickel	MIL-STD-865C	任意尺寸	半导体业界最高规格
不锈钢 Stainless steel	化学清洗 Chemical Cleaning	ASTM/GB	2000×800× 1000mm	半导体业界最高UHV规格
	钝化 Passivation	ASTM-A-967	2000×800× 1000mm	达到美军规要求
	喷砂 Bead-blasting	ASTM/GB	900×800×580mm	Ra:1-10 μm (精度±10%)
	电解抛光 ElectroPolishing	ASTM-B-912	1500× 1000×800mm	半导体业界最高规格 CPT > 25℃
塑料 Plastic	化学清洗 Chemical Cleaning	ASTM/GB	2000×800× 1000mm	半导体业界规格

主要设备 - 精密检测

Capabilities-QC



三次元测量设备:

目前公司配置了三次元1台: 测量范围:
:1500 X 1000MM 精度:0.83UM

可实现中等大小半导体零件所有形位公差和尺寸的精密测量



ICP-MS 等离子体质谱仪



OGP 光学影像测量仪



Thermo 手持式合金分析仪

Coating Tester 阳极测试仪

VARIAN Helium leak tester
氦气测漏仪



Roughness Tester 粗糙度测量仪

Part 4

帝京客户群

我们的客户



日立高新



持续增加中。...

梦想成就未来

 DJ-Semicon
帝京半导体